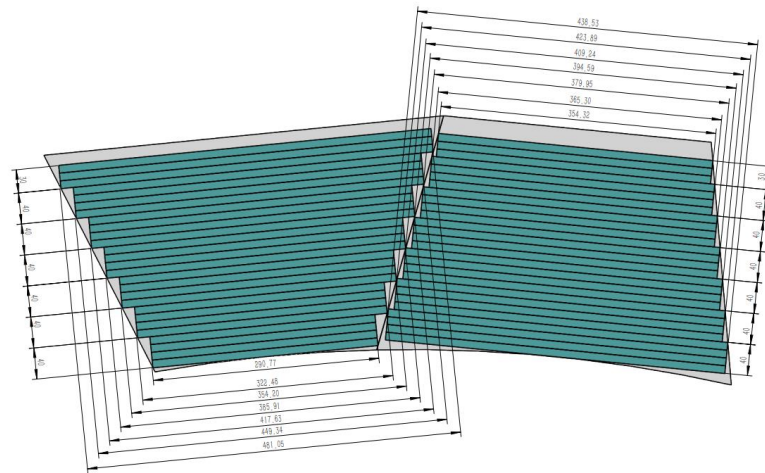
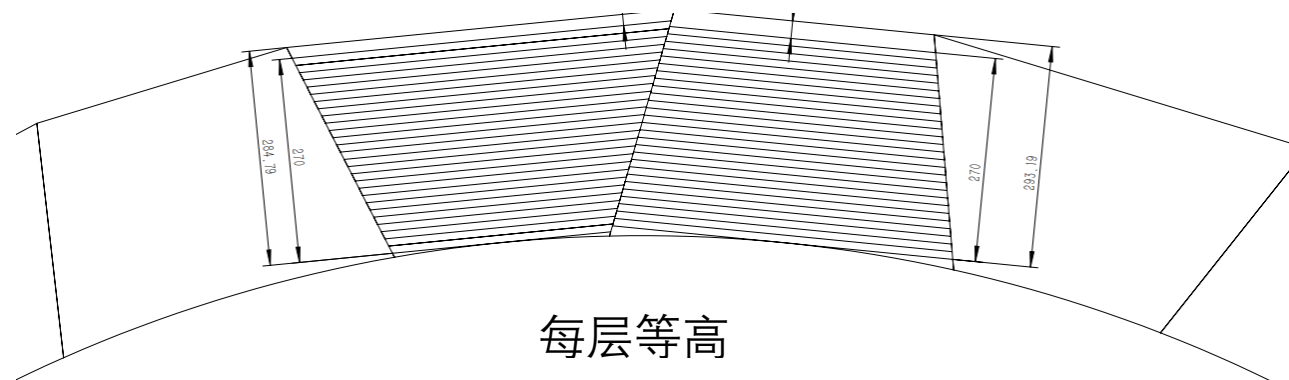
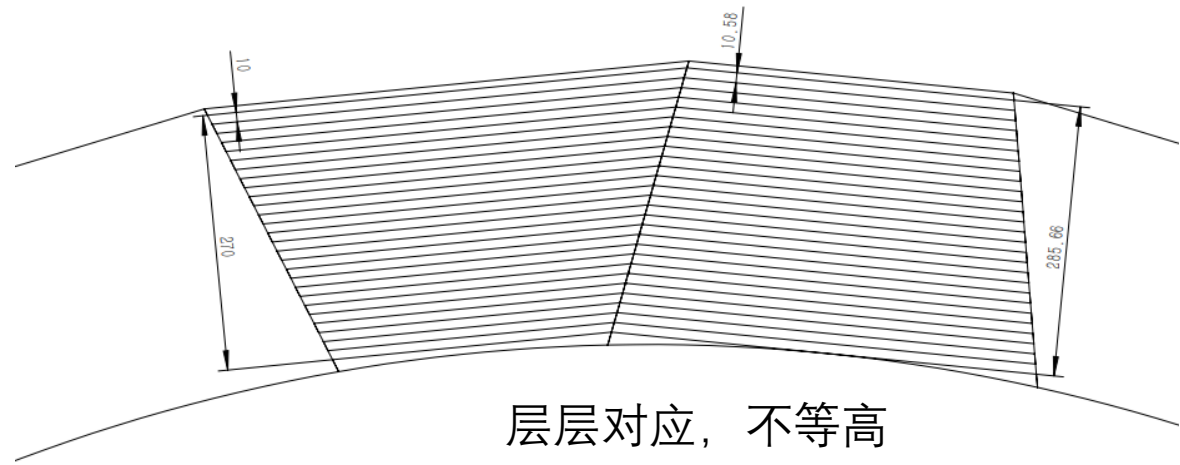
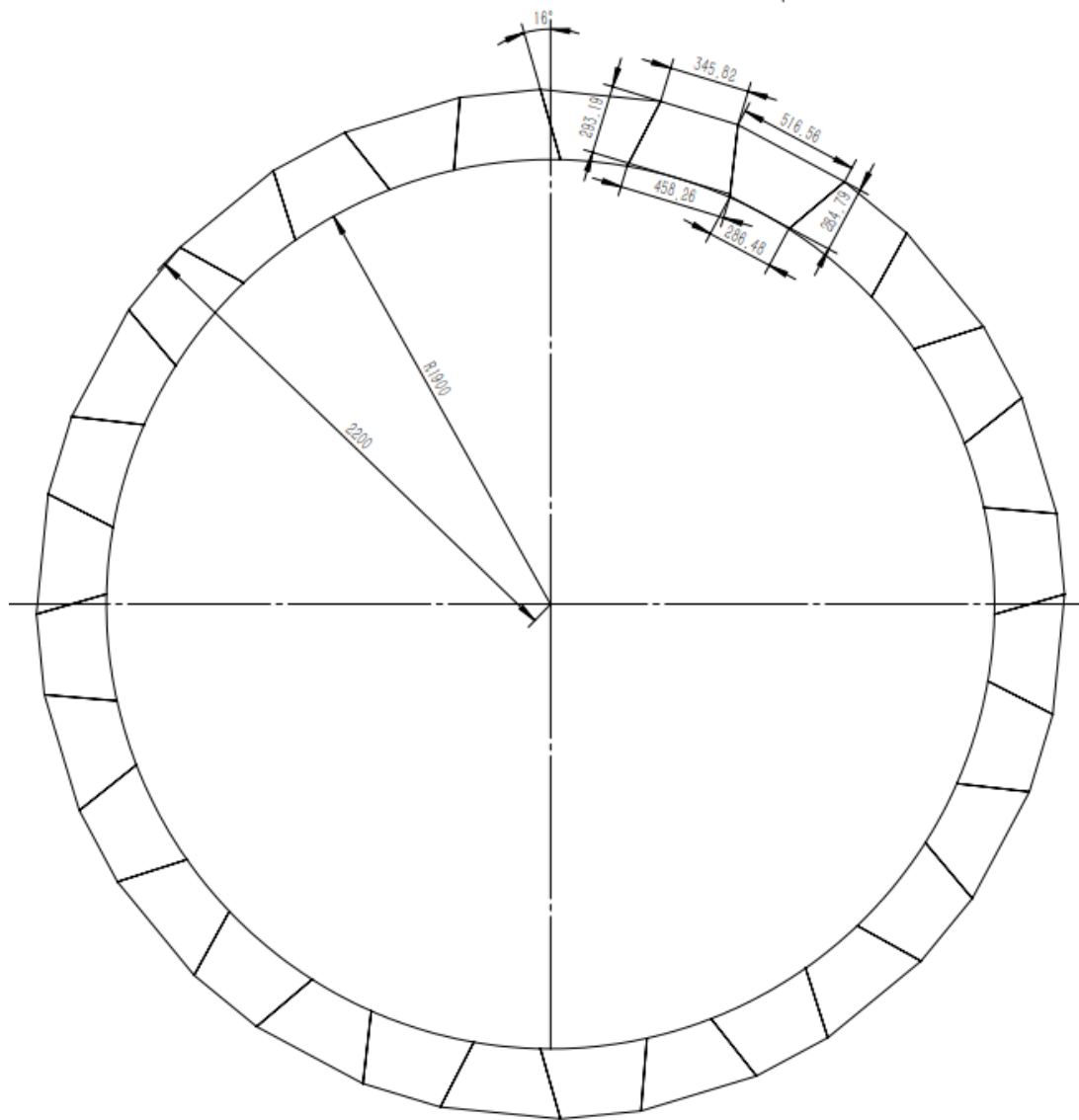


# 正反梯形方案





## 散热估算

铜片导热的原理是热传导，其传热方程可以表示为：

$$q=-kA(dT/dx)$$

其中 $q$ 为单位时间内导热量， $k$ 为材料的导热系数， $A$ 为热交换面积， $dT/dx$ 为温度梯度。

铜导热系数 $k=401W/(m*k)$

在晶体单元中，热交换面积可默认为电子学板的面积 $40cm*30cm$

温度梯度假设为 $10^{\circ}C/30cm$

可得导热量为 $1600W$ ，对应每个电子学板。

# 圆环方案

